




RAM memory	4 GB
Fecha de lanzamiento	Q2
Número de procesador	525
Caché L2	1 MB
DMI	2.5 GT/s
Conjunto de instrucciones	64-bit
Extensiones de conjunto de instrucciones	SSE2, SSE3, SSSE3
Opciones integradas disponibles	Yes
Litografía	45 nm
Rango de voltaje VID	0.800V-1.175V
Hoja de datos	Link

-

Cantidad de núcleos	2
Cantidad de subprocesos	4
Frecuencia básica del procesador	1.8 GHz
TDP	13 W

-

Tamaño de memoria máximo (depende del tipo de memoria)	4 GB
Tipos de memoria	DDR3 800 (SODIMM only); DDR2 667/800
Cantidad máxima de canales de memoria	1
Máximo de ancho de banda de memoria	6,4 GB/s
Extensiones de dirección física	32-bit
Compatible con memoria ECC † 	No






-

Gráficos del procesador †	Integrated
---------------------------	------------


-

T _{JUNCTION}	100°C
Tamaño de paquete	22mm x 22mm
Tamaño de chip de procesamiento	87 mm ²
Cantidad de transistores de chip de procesador	176 million
Zócalos compatibles	FCBGA559
Baja concentración de opciones de halógenos disponibles	Consultar MDDS


-

Versión de la tecnología Intel® Turbo Boost †	No
Tecnología Hyper-Threading Intel® † 	Yes
Tecnología de virtualización Intel® (VT-x) †	No
Tecnología de virtualización Intel® para E/S dirigida (VT-d) † 	No
Intel® 64 † 	Yes
Estados de inactividad	No
Tecnología Intel SpeedStep® mejorada 	No
Conmutación según demanda Intel® 	No
Tecnologías de monitoreo térmico	No

-

Nuevas instrucciones de AES 	No
--	----

-

Tecnología Trusted Execution † 	No
Bit de desactivación de ejecución †	Yes